

Title (en)  
Leakproof ceramic tiles for floor or wall covering

Title (de)  
Flüssigkeitsdichter Boden- oder Wandbelag aus keramischen Platten

Title (fr)  
Dalles céramiques étanches pour le revêtement de sols ou de murs

Publication  
**EP 0884434 A2 19981216 (DE)**

Application  
**EP 98109826 A 19980529**

Priority  
DE 19724296 A 19970609

Abstract (en)  
The lining (1), above a supporting base (2), e.g. a concrete plate or wall, comprises at least the following parts:- an adhesion bridge layer (12), which is electrically conductive, and in which is embedded an electrically non-conductive ceramic plate layer (10). Also included is an electrically non-conductive seam filling (11) in the upper part of the seam not filled by the adhesive bridge layer (12) and located between the individual plates (10) of the plate layer. Below or above or in the adhesive bridge layer (12), in direct contact with the layer, is an additional netting layer (13) of electrically conductive material, which with at least one contact point outside or above the layer (1) is electrically connected or connectable.

Abstract (de)  
Die Erfindung betrifft einen flüssigkeitsdichten Boden- oder Wandbelag (1) aus keramischen Platten (10), der durch ein auf einer elektrischen Durchschlagfestigkeitsmessung beruhendes Verfahren auf seine Dichtigkeit überprüfbar ist, wobei der Belag (1) oberhalb eines tragenden Untergrundes (2), z.B. eine Betonplatte oder Mauer, zumindest folgende Teile umfaßt: eine Haftbrückenschicht (12), die elektrisch leitfähig ist, eine in die Haftbrückenschicht (12) eingebettete, elektrisch nichtleitende keramische Plattenlage (10) und eine elektrisch nichtleitende Fugenfüllung (11) in dem nicht von der Haftbrückenschicht (12) ausgefüllten oberen Teil der Fugen zwischen den einzelnen Platten (10) der Plattenlage. Der erfindungsgemäße flüssigkeitsdichte Boden- oder Wandbelag ist dadurch gekennzeichnet, daß unter oder über oder in der Haftbrückenschicht (12) in unmittelbarem Kontakt mit dieser zusätzlich eine Netzlage (13) aus einem elektrisch leitfähigen Material angeordnet ist, die mit mindestens einem außerhalb oder oberhalb des Belages (1) angeordneten Kontaktspurknoten elektrisch verbunden oder verbindbar ist. <IMAGE>

IPC 1-7  
**E04F 15/02**

IPC 8 full level  
**E04F 15/02** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**E04F 15/02** (2013.01)

Cited by  
US6635316B1; EP1033440A1; CZ296929B6; US7084776B2; WO0059843A1

Designated contracting state (EPC)  
BE CH FR GB IT LI LU NL

DOCDB simple family (publication)  
**DE 19724296 A1 19981210; DE 19724296 C2 19990610; EP 0884434 A2 19981216; EP 0884434 A3 19990526; EP 0884434 B1 20020731**

DOCDB simple family (application)  
**DE 19724296 A 19970609; EP 98109826 A 19980529**